



## Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Prozessormodul
Produktspezifische Anwendung	Robuste Ausführung

## Zusatzmerkmale

Anzahl von Racks	4
Lokale E / A-Prozessorkapazität (diskret)	2.048 E/A
Lokale E / A-Prozessorkapazität (analog)	512 E/A
Anzahl der anwendungsspezifischen Kanäle (lokales Gestell)	72
Anwendungsspezifischer E/A	Zähler HART SSI-Encoder Genaue Zeitstempelung Motion Control Serielle Schnittstelle
Prüfungen	Prozesssteuerung
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise
Integrierte Verbindungsart	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätnetzwerk USB Typ Mini-B
Anzahl entfernter E/A-Stationen	8 - 2 Einbaugehäuse pro Remote-Station (RIO drop)
Anzahl verteilter Geräte	64
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors	2 Ethernet-Kommunikationsmodul 8 AS-Interface-Modul
Kommunikationsdienst	RIO-Scanner DIO-Scanner
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 8 MB für Programm Integriert RAM, 768 kB für Daten
Anwendungsstruktur	1 periodische Fast Task 64 Ereignis-Tasks 1 zyklisch/periodische Master Task 2 Hilfs-Tasks
Anzahl der Anweisungen pro ms	7,5 Kinst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch 10 Kinst/ms 100 % boolesch
Stromaufnahme	270 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	775000 H
Beschriftung	CE



## Montage




Vibrationsfestigkeit	3 gn
Stoßfestigkeit	30 gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Handelsmarine[RETURN] Zone 2/22[RETURN]IECEx Zone 2/22
Normen	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2 EN/IEC 61850-3, Standort G EN/IEC 60079-0
Umgebungseigenschaften	Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04 Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3 Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Gefahrenbereich Klasse I Division 2
Beschichtung	Schutzlack
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
LED-Statusanzeige	1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus)
Produktgewicht	0,849 kg

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	25,500 cm
VPE 1 Gewicht	881,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,700 kg

## Nachhaltigkeit

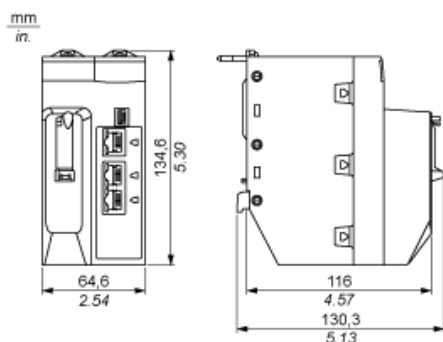
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

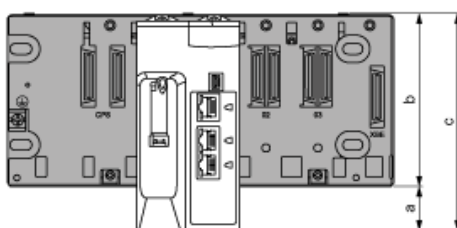
## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

## Nur CPU-Module

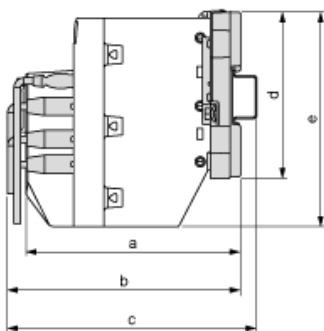


## Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.) Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Haupttracks, 134,6 mm (5.299 in.)

## In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schientiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)